

Boschman Advanced Packaging Technology

Stenograaf 3
6921 EX Duiven
The Netherlands

T +31 (0)26 319 4900
E info@boschman.nl

www.boschman.nl

Boschman is a high-tech, technology driven company, specialized in advanced back-end semiconductor packaging solutions. We are headquartered in the Netherlands with a system assembly facility in Singapore and expanding in China.

We focus on Pressure Sintering and Transfer Molding, two technologies that are in high demand now as the world is converting to high levels of electrification, creating unprecedented opportunities for companies active in the power electronics supply chain.

Core to our strategy is a unique business model, "from Idea to Industrialization", with 3 highly complementary activities:

- **Package Development:** co-development of semiconductor packages and processes, including concept and design for manufacturing (DFM), prototyping and engineering samples for our (end) customers. Historically this activity was mainly focused on MEMS and Sensors, but is currently shifting towards Power Modules and Inverters, driven by market demand in the xEV segment.
- **Assembly Services:** small to medium volume micro assembly of MEMS, Sensors and Power Modules, with a fully equipped inhouse lab (from wafer dicing to die attach bonding, molding and laser marking). For higher production volumes, we can support to transfer the production to in-house production or high-volume OSAT.
- **Production Equipment:** pressure sintering & transfer molding equipment, a range of systems from R&D Labs to High Volume production solutions.



Johan Hamelink
Sales Account Manager VP Sales
and Business Development Asia
T +31 6 5123 1091
E johanhamelink@boschman.nl



Keiichi Nishimura
Representative Boschman in Japan
T +81 48 280 5701
E k-nishimura@alphacorpjp.com

ボッシュマン社は、先進的な後工程半導体パッケージング・ソリューションに特化した、ハイテクで技術主導型の企業です。オランダに本社を置き、シンガポールにシステム組立施設を持ち、中国にも進出しています。

私たちは、世界が高度に電化され、パワーエレクトロニクスのサプライチェーンで活躍する企業にかつてないチャンスをもたらしている今、需要が高まっている2つの技術、加圧焼結とトランスファー成形に焦点をあてています。

当社の戦略の核となるのは、「アイデアから製品化まで」という独自のビジネスモデルであり、相互補完性の高い3つの事業で構成されています。

- **パッケージ開発:** 半導体パッケージとプロセスの共同開発で、コンセプトと製造用設計 (DFM)、プロトタイプング、エンジニアリングサンプルを顧客向けに提供。従来、この活動は主にMEMSとセンサーに集中していましたが、現在はxEVセグメントにおける市場の需要に牽引され、パワーモジュールとインバーターにシフトしています。
- **アセンブリサービス:** MEMS、センサー、パワーモジュールの小～中量マイクロアセンブリで、社内ラボを完備 (ウェハダイシングからダイアタッチボンディング、モールディング、レーザーマーカーキングまで)。生産量が多い場合は、自社生産への移行や量産型OSATへの移行をサポートします。
- **生産設備:** 加圧焼結装置、トランスファー成形装置、R&Dラボから大量生産ソリューションまで、さまざまなシステム。